

Title (en)

Manufacturing process for microwave cavities, cores utilised in this process and cavities obtained by this process.

Title (de)

Herstellungsverfahren für Mikrowellenhohlräume, bei diesem Verfahren verwendete Kerne und durch dieses Verfahren erhaltene Hohlräume.

Title (fr)

Procédé de fabrication de cavités hyperfréquences, noyaux utilisés dans ce procédé et cavités obtenues par ce procédé.

Publication

**EP 0018885 A1 19801112 (FR)**

Application

**EP 80400524 A 19800418**

Priority

FR 7911024 A 19790502

Abstract (en)

Method permitting simultaneous fabrication, by electroforming, of a cavity and the integrated parts (partitions, membranes, rods, etc...) which it contains. Onto a core (4) whose external surface reproduces the internal surface of the cavity to be made and in which are hollowed out holes corresponding to the integrated parts to be made in the cavity, are deposited successively an adhering sub-layer, a sub-layer conductive under high frequency, and a copper layer. The core (4) which can consist of several elements (40, 41, 42) is disengaged from the cavity by simple extraction in the case of the elements whose position and shape thus permit (41, 42), and by dissolving in the case of the other elements (40). Application to microwave cavities. <IMAGE>

Abstract (fr)

Procédé permettant de fabriquer en une seule fois, par électroformage, une cavité et les pièces intégrantes (cloisons, iris, tiges, etc ...) qu'elle contient. Sur un noyau (4) dont la surface externe reproduit la surface interne de la cavité à réaliser et dans lequel sont creusés des trous correspondant aux pièces intégrantes à réaliser dans la cavité, sont déposées successivement une sous-couche d'adhérence, une sous-couche conductrice en haute fréquence, et une couche de cuivre. Le noyau (4) qui peut être constitué de plusieurs éléments (40, 41, 42) est dégagé de la cavité par simple extraction pour les éléments dont la position et la forme le permettent (41, 42), par dissolution pour les autres éléments (40). Application aux cavités hyperfréquences.

IPC 1-7

**H01P 11/00**

IPC 8 full level

**H01P 11/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H01P 11/008** (2013.01)

Citation (search report)

- H.W. DETTNER et al.: "HANDBUCH DER GALVANOTECHNIK", Vol. 2, 1966 Carl Hanser Verlag Munich DE. \* Pages 654 -655, paragraphes 19.22, 19.23 et 19.241; page 660, ligne 5; pages 662-663, paragraphe 19-253; page 751, paragraphe 21.7, alinea 1; page 789, paragraphe 22.025, dernier alinea et paragraphe 22.025.1, alinea 1; pages 797-799, paragraphe 22.025.4; page 526, paragraphe 17.156. 104, alinea 2 \*
- H.W. DETTNER et al.: "HANDBUCH DER GALVANOTECHNIK", Vol. 1, 2eme partie, 1964 Carl Hanser Verlag Munich DE. \* Pages 788-791, paragraphes 11.082 et 11.083; page 1029, lignes 34-41; pages 1035 - 1037, paragraphe 15.131, alineas 1,2,3 et dernier alinea; pages 1040-1041, paragraphe 15.14 \*
- TELEFUNKEN-ZEITUNG, Vol. 37, No. 2, 1964 Berlin DE E. BERTL et al.: "Galvanoplastische Herstellung von engtolerierten Hohlleiter-Bauelementen", pages 149-153. \* En entier \*

Cited by

EP0388290A1; FR2541517A1; EP0091352A1; FR2524718A1; EP0129453A1; FR2546333A1

Designated contracting state (EPC)

DE GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0018885 A1 19801112**; FR 2455801 A1 19801128; FR 2455801 B1 19850315

DOCDB simple family (application)

**EP 80400524 A 19800418**; FR 7911024 A 19790502